第48期 中間報告書

平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで

東京エレクトロン株式会社

目次

株主のみなさまへ..... 1
主要な事業内容..... 3
CLOSE UP..... 5
半導体(IC)製造プロセス 7
TFT-LCD製造プロセス／
薄膜シリコン太陽電池製造プロセス.. 8
業績等の推移..... 9
連結財務諸表.....11
株式の状況.....13
会社の概況等.....14
株主メモ

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。また、平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

当社グループ第48期中間期（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）報告書として、事業の概況等をご報告いたします。

平成22年11月２日開催の当社取締役会において、第48期中間配当を１株につき38円、その支払開始日を平成22年12月１日とすることを決議いたしました。第48期中間配当金は、同封の「配当金領収証」により、平成22年12月１日から平成23年１月７日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行等でお受け取りください。金融機関預金口座振込・ゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」のとおり、また、証券会社等の口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」のとおり振込手続きをいたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

加えて、当社は平成22年11月２日開催の取締役会において、配当政策の変更に関しましても決議いたしました。

当社は、利益成長を通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し、成長分野に重点的に投資するとともに、業績連動型・収益対応型配当により、株主各位に対して還元をさせていただいてまいりました。将来の成長の

礎となる研究開発・設備・人材への投資につきましては、引き続き積極的に実施する方針には変更ありませんが、事業や財務状況に関する中期的見通しを検討した結果、このたび、より積極的な株主還元策として連結配当性向を引き上げることとしました。具体的には、平成23年３月期期末配当から、連結当期純利益に対する配当性向20％を目途とする方針から、35％を目途とする方針に変更するものであります。

事業の概況

当中間期の世界経済は、欧米景気の停滞懸念などもあり、期後半にかけては先行き不透明感を示しましたが、中国・インドを中心とした新興国の内需拡大により堅調でした。また日本経済は、円高による影響や雇用環境に引き続き厳しさが残るものの、設備投資が下げ止まり、輸出が上向くなど、緩やかな回復傾向を示しました。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、ここに来て在庫水準上昇などの若干の調整局面も見受けられますが、パソコン需要の継続的な拡大に加え、薄型テレビなどのデジタル家電、スマートフォン（高機能携帯電話）市場が全般的に好調に推移し、これらの基幹部品である半導体・FPD関連市場は順調でした。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の連結業績は、前期下半期に引き続き業績回復となり売上高3,184億円（前年同期比106.9%増）、営業利益423億４千２百万円（前年同期は216億２千万円の営業損失）、経常利益451億７百万円（前年同期は192億１千２百万円の経常損失）、また、純利益は334億５千４百万円（前年同期は161億６千１百万円の純損失）となりました。

当社グループは、利益志向の経営のもと、顧客第一主義、製品開発力・技術開発力の向上、国際競争力の強化、及び従業員の活性化に取り組むことによって、今後も企業価値の向上を推進してまいる所存でありますので、株主各位の一層のご支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申しあげます。

平成22年11月

代表取締役社長 兼 CEO
竹中　博司

主要な事業内容（平成22年９月30日現在）

東京エレクトロングループは、エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置、ＦＰＤ及びＰＶ（太陽電池）製造装置の製造・販売並びに電子部品・情報通信機器の購入・販売を事業の中心としております。各部門の事業の状況及び主要な営業品目は、次のとおりであります。

部　門	事業の状況	主要営業品目
半導体 製造装置	世界経済の回復を背景に、スマートフォンやタブレットPCなど半導体を搭載するアプリケーションが新興国においても市場拡大し、半導体需要が増加しました。加えて、微細化投資も加速されたことを受け、前工程の設備投資は前期に比べ大幅に増加しました。このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、2,402億２千９百万円（前年同期比192.5%増）となりました。	●熱処理成膜装置 ●コータ／デベロッパ ●プラズマエッチング装置 ●洗浄装置 ●枚葉成膜装置 ●ウェーハプローバ ●各種測定装置
FPD／PV 製造装置	FPD製造装置を取り巻く環境につきましては、薄型テレビの底堅い需要等により堅調に推移するなか、パネルメーカーによる新規設備投資も中国を中心に継続しております。当社グループは、今後一層の拡大が予想される中国市場を鑑み、江蘇省昆山市に製造拠点を新設することを決定いたしました。また、太陽電池製造装置分野につきましては、現状は黎明期ではありますが、中長期的には大きなビジネス成長が期待されています。このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、328億６千万円（前年同期比6.9%増）となりました。	●FPDコータ／デベロッパ ●FPDプラズマエッチング／アッシング装置 ●PV用プラズマCVD装置
電子部品・ 情報通信機器	半導体及び電子デバイス分野では、医療機器やFA機器、半導体製造装置等の産業機器関連の需要が好調に推移し、アナログICやカスタムICの売上が伸長しました。コンピュータシステム関連分野は、企業のIT投資に対する姿勢が引き続き慎重ななか、保守関連ビジネスが堅調に推移しました。このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、450億７千５百万円（前年同期比10.5%増）となりました。	●半導体製品 ●ボード製品 ●一般電子部品 ●コンピュータ・ネットワーク機器 ●ソフトウェア

（注）製品名及び会社名は、各社の商標又は登録商標です。

主要取扱い製品

コータ／デベロッパ
CLEAN TRACK® LITHIUS Pro® V-i

プラズマエッチング装置
Tactras®

熱処理成膜装置
TELINDY PLUS®

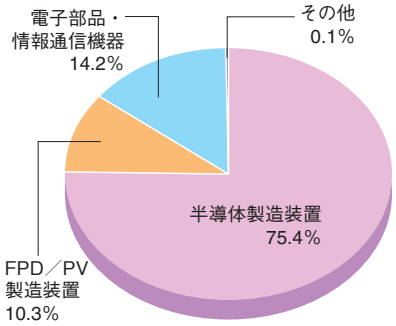
FPDコータ／デベロッパ
CRYSTAL LINER® シリーズ CL1200

FPDプラズマエッチング／アッシング装置
Impressio®

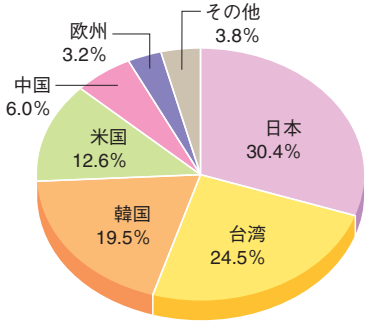
ザイリンクス社
FPGA

F5ネットワークス社
BIG-IP

■連結 部門別売上構成比（第2四半期累計）



■連結 地域別売上構成比（第2四半期累計）



CLOSE UP

宮城県大和町で新工場着工

平成22年７月、宮城県大和町の大和リサーチパークにおきまして、新工場建設に着手いたしました。

新工場の稼動開始は来春の予定で、今後の市場規模拡大とシェア向上が期待される半導体用エッチング装置の開発から量産までを一貫して行います。エッチング工程は、半導体（IC）の製造プロセスにおいて、シリコンウェーハ上に成膜した薄膜を回路パターンに沿って化学反応で削り取る非常に重要な技術であり、当社の主力事業のひとつとなっております。新工場では、生産方式の改革により、生産性の向上と工期短縮を目指す他、新プラズマ技術であるRLSA（Radial Line Slot Antenna）を用いた装置の量産も行ってまいります。

新工場の敷地面積は約30万平米、３棟（生産棟・開発棟・事務棟）で構成される建物の総延床面積は約７万平米です。また、生産棟・開発棟の屋上に1,000キロワット級の大規模な太陽光発電の設置に加え、

宮城新工場完成予想図

省エネ設備なども積極的に導入し、環境に配慮した工場を実現していきます。

設置予定の太陽光発電パネル

平成22年７月23日　起工式
東京エレクトロン(株) 代表取締役社長　　竹中　博司（写真右側）
東京エレクトロン宮城(株) 代表取締役社長　北山　博文（写真左側）

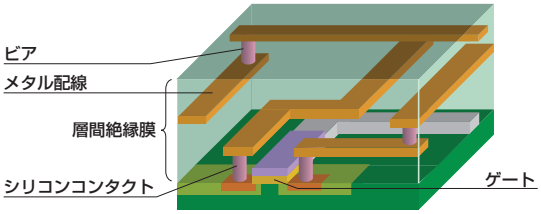
宮城新工場におきましては、重要技術の内製化を進めるとともに、研究・開発から製造に至るまでの一貫体制を整えてまいります。また、製品差別化に加え、開発段階から品質、工程、コスト、環境対応などの課題に幅広く取組み、お客様に対し価値の高い製品を提供してまいります。

RLSAを含めた当社エッチング装置の事業規模を現在の約２倍にすることを目標に据え、世界で勝てる技術・製品を新工場から創出してまいります。

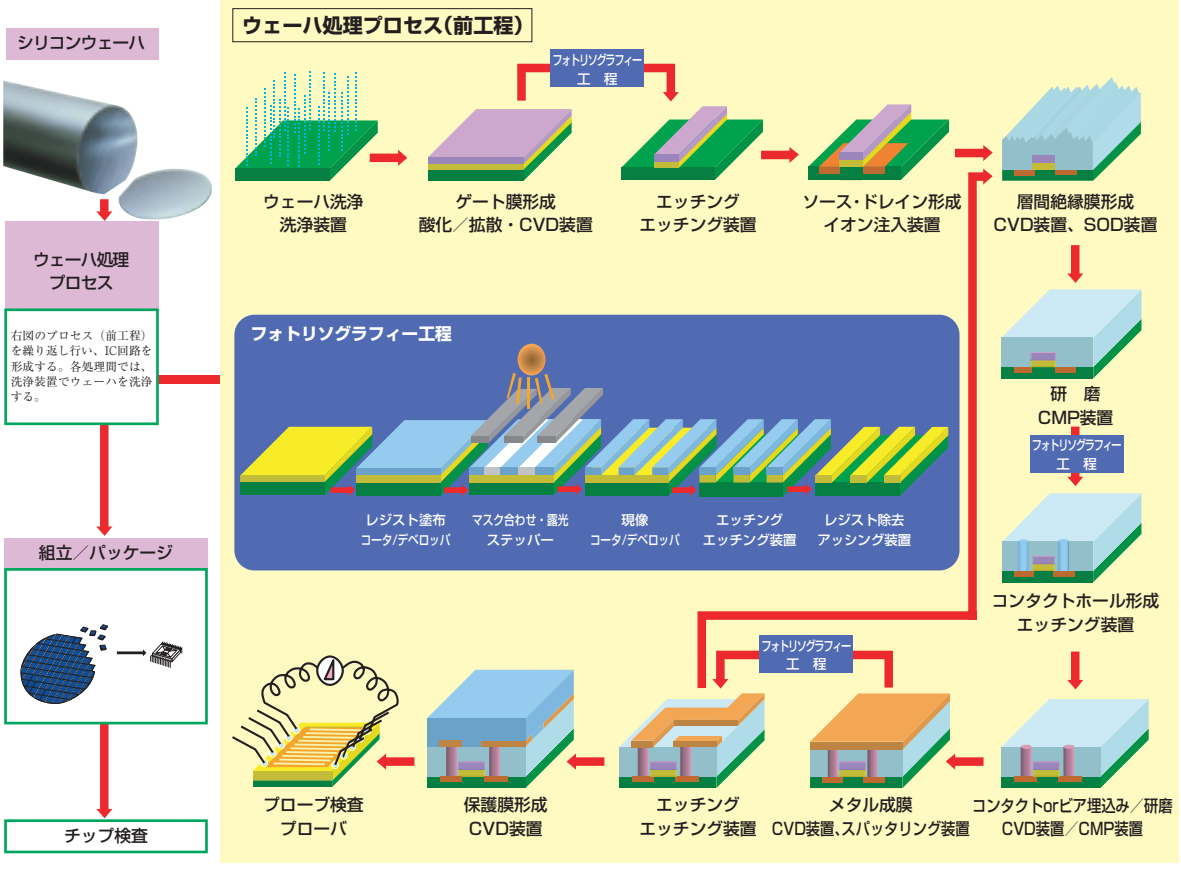
東京エレクトロン宮城(株)
代表取締役社長　北山　博文

半導体（IC）製造プロセス

半導体は、たくさんのトランジスタや抵抗などの素子とそれらをつなぐ配線からなる複雑な構造となっております（右モデル図参照）。また、その製造プロセスは、主にシリコンウェーハ上に金属や絶縁体の薄膜を重ね合わせることと、不要な部分を削り取ることを繰り返して回路を形成する前工程と、組立・パッケージングを行う後工程の二つに分けられます。当社はこのうち、前工程のほぼ全てをカバーする製品群をラインアップし、お客様より高い評価をいただいております。



ICの内部構造（モデル図）



用語解説

CVD（Chemical Vapor Deposition）
ウェーハ表面に原料となるガスを流し、熱やプラズマを利用して化学反応で薄膜を堆積させる技術。

エッチング
CVDなどで成膜した薄膜を化学反応で取り去る技術。

SOD（Spin on Dielectric）
配線と配線の間を埋める絶縁膜を液体の原料を用いて回転塗布法で成膜する技術。

CMP（Chemical Mechanical Polishing）
機械的加工と化学反応により形成した薄膜を平坦化する技術。

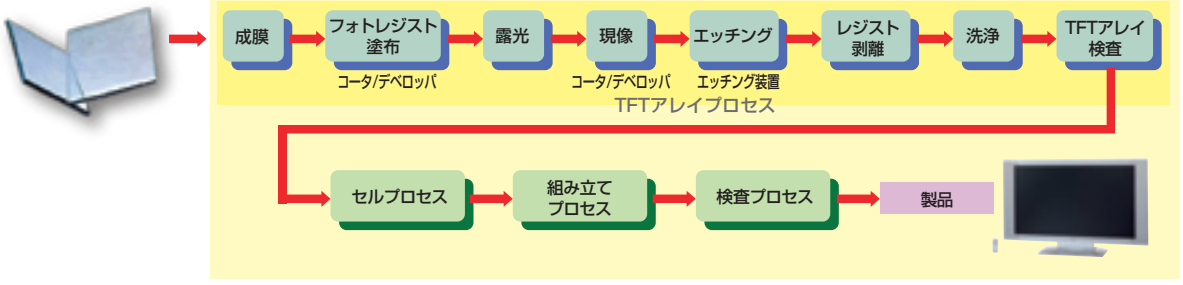
TFT-LCD製造プロセス／薄膜シリコン太陽電池製造プロセス

半導体製造装置の開発によって培った高い技術力が、現在当社グループを代表する製品のひとつであるFPD製造装置に応用されております。また、半導体製造装置及びFPD製造装置で培った真空プラズマを用いた量産装置技術が、太陽電池製造装置事業に活かされております。

※TFT…Thin Film Transistorの略。薄膜トランジスタ。

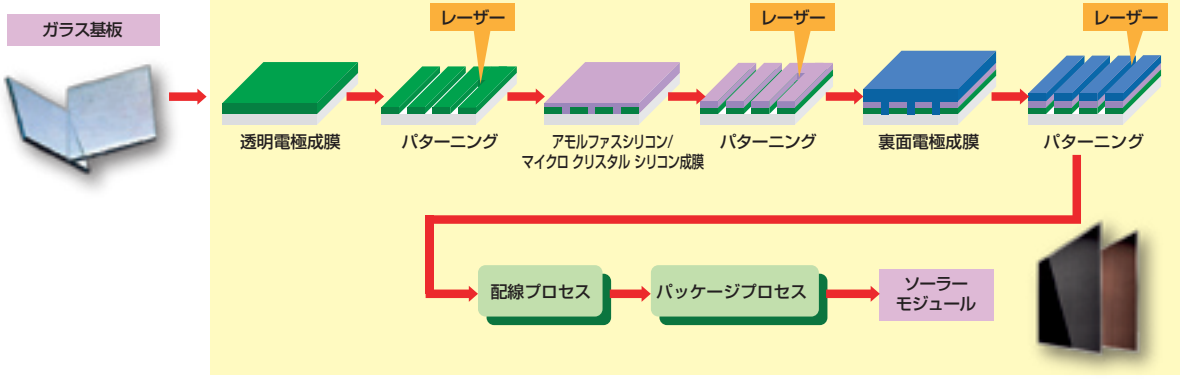
TFT-LCD製造プロセス

FPD製造の要となるTFTアレイプロセス（前工程）は、半導体製造におけるウェーハ処理プロセス（前工程）とほぼ同様の工程です。



薄膜シリコン太陽電池製造プロセス

薄膜シリコン太陽電池は、シリコン材料の使用量が少なく、低コストで大規模量産可能であることから近年注目を浴びている太陽電池の一種で、ガラス基板上に薄膜シリコンの発電層を形成するタイプの太陽電池です。



当社グループの太陽電池製造装置事業について

◆シャープ㈱と合弁会社を設立し、薄膜シリコン発電層成膜用プラズマCVD装置の開発・製造を行っています。
◆アジア及びオセアニア地域におけるエリコン・ソーラー社（スイス）の独占販売代理店として、薄膜シリコン太陽電池用一貫製造ラインの販売及びサポートを行っています。

連結業績

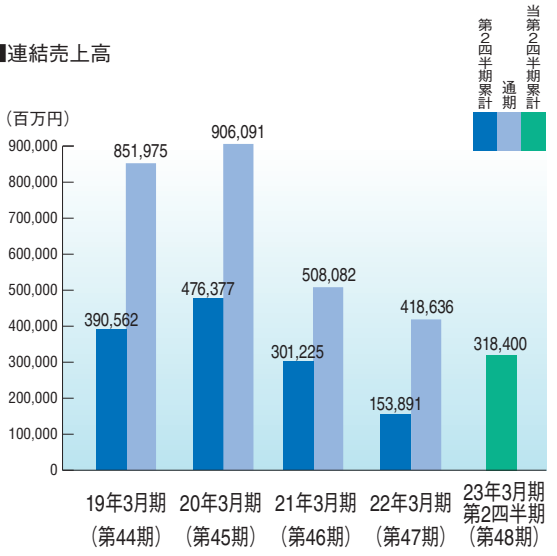
区分＼期別	第48期 第２四半期累計 平成22年4月１日から 平成22年9月30日まで	第47期 第２四半期累計 平成21年4月１日から 平成21年9月30日まで	第47期 通期 平成21年4月１日から 平成22年3月31日まで
売上高（百万円）			
半導体製造装置	240,229	82,136	262,391
FPD/PV製造装置	32,860	30,743	71,361
電子部品・情報通信機器	45,075	40,799	84,473
その他	234	211	410
合　計	318,400	153,891	418,636
営業利益（百万円）	42,342	△ 21,620	△ 2,180
経常利益（百万円）	45,107	△ 19,212	2,558
四半期（当期）純利益（百万円）	33,454	△ 16,161	△ 9,033
総資産（百万円）	752,576	653,540	696,351
純資産（百万円）	550,607	514,515	523,369
１株当たり四半期（当期）純利益（円）	186.88	△ 90.30	△ 50.47

（注）1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
3. △は、損失を示しております。

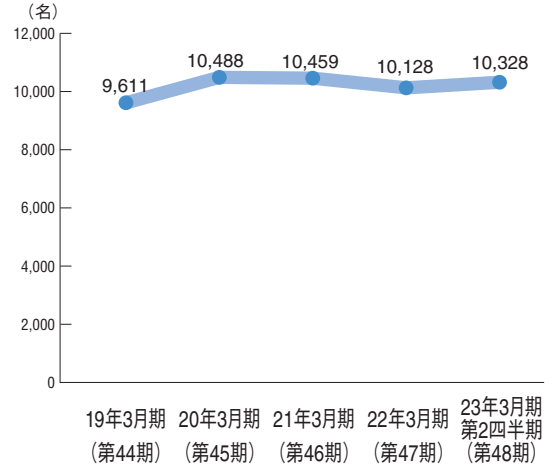
当社配当状況

期別	第48期 中間	第47期 中間	第47期 年間
１株当たり配当金（円）	38	4	12

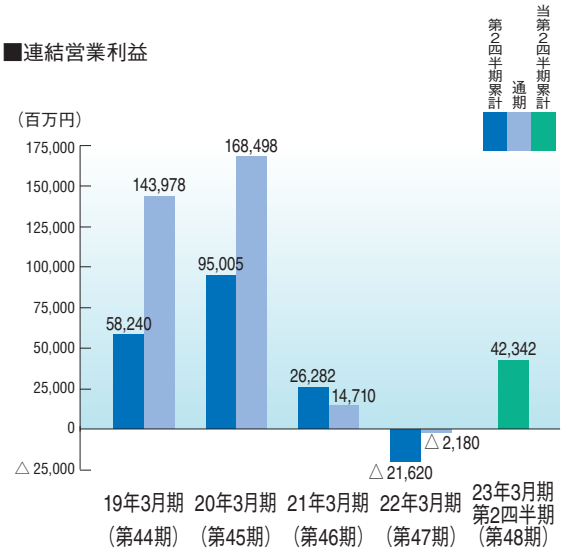
■連結売上高



■連結グループ従業員数

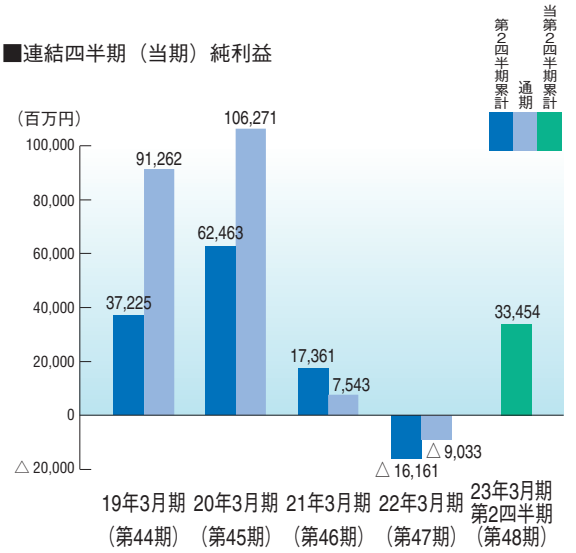


■連結営業利益



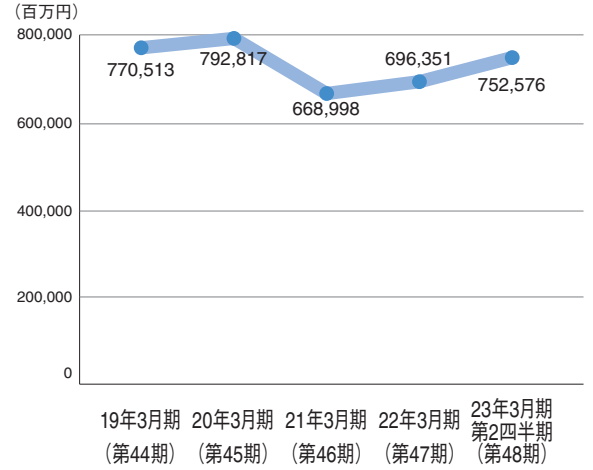
（注）△は、損失を示しております。

■連結四半期（当期）純利益

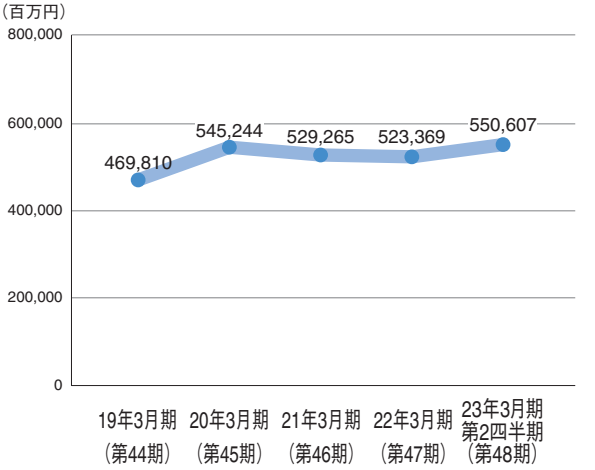


（注）△は、損失を示しております。

■連結総資産



■連結純資産



連結貸借対照表

単位：百万円

科目＼期別	第48期 第2四半期末 (平成22年9月30日現在)	第47期末 (平成22年3月31日現在)
資産の部		
流動資産	**602,277**	**552,939**
現金及び預金	57,403	56,939
受取手形及び売掛金	121,605	124,462
有価証券	211,000	187,000
商品及び製品	105,727	87,201
仕掛品	46,891	37,793
原材料及び貯蔵品	13,331	13,455
その他	47,350	46,263
貸倒引当金	△ 1,031	△ 176
固定資産	**150,298**	**143,412**
有形固定資産	**100,016**	**92,127**
無形固定資産	**4,829**	**5,586**
その他	4,829	5,586
投資その他の資産	**45,452**	**45,698**
その他	49,445	53,151
貸倒引当金	△ 3,993	△ 7,452
資産合計	**752,576**	**696,351**

科目＼期別	第48期 第2四半期末 (平成22年9月30日現在)	第47期末 (平成22年3月31日現在)
負債の部		
流動負債	**147,353**	**119,161**
支払手形及び買掛金	58,292	52,359
未払法人税等	15,814	4,355
賞与引当金	9,897	6,043
その他の引当金	7,168	5,294
その他	56,179	51,109
固定負債	**54,615**	**53,820**
退職給付引当金	51,224	49,906
その他の引当金	619	621
その他	2,771	3,291
負債合計	**201,968**	**172,982**
純資産の部		
株主資本	**548,485**	**516,065**
資本金	**54,961**	**54,961**
資本剰余金	**78,045**	**78,034**
利益剰余金	**425,992**	**393,970**
自己株式	**△ 10,513**	**△ 10,900**
評価・換算差額等	**△ 9,513**	**△ 4,247**
その他有価証券評価差額金	**1,134**	**2,504**
繰延ヘッジ損益	**65**	**△ 67**
為替換算調整勘定	**△ 10,713**	**△ 6,683**
新株予約権	**1,397**	**1,578**
少数株主持分	**10,237**	**9,973**
純資産合計	**550,607**	**523,369**
負債純資産合計	**752,576**	**696,351**

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

単位：百万円

科目＼期別	第48期 第2四半期累計（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）	第47期 第2四半期累計（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）
売上高	**318,400**	**153,891**
売上原価	209,683	123,020
売上総利益	**108,717**	**30,870**
販売費及び一般管理費	66,375	52,490
研究開発費	34,120	25,173
その他	32,254	27,317
営業利益又は営業損失(△)	**42,342**	**△ 21,620**
営業外収益	**2,947**	**2,676**
受取利息	376	554
補助金収入	1,836	939
その他	734	1,182
営業外費用	**182**	**269**
固定資産賃貸費用	—	88
閉鎖拠点維持管理費用	104	—
その他	77	180
経常利益又は経常損失(△)	**45,107**	**△ 19,212**
特別利益	**506**	**43**
貸倒引当金戻入額	309	19
拠点統廃合関連費用戻入益	120	—
固定資産売却益	—	24
その他	76	—
特別損失	**564**	**7,080**
固定資産除売却損	399	—
減損損失	122	4,764
拠点統廃合関連費用	—	1,564
その他	42	751
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	**45,049**	**△ 26,249**
法人税等	11,193	△ 10,234
少数株主損益調整前四半期純利益	33,856	—
少数株主利益	402	146
四半期純利益又は四半期純損失(△)	**33,454**	**△ 16,161**

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

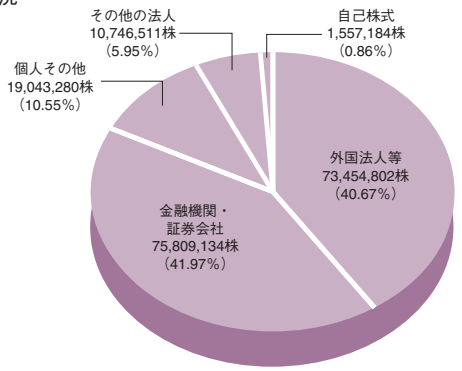
科目＼期別	第48期 第2四半期累計（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）	第47期 第2四半期累計（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー	**41,187**	**40,367**
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	45,049	△ 26,249
減価償却費	7,819	9,885
減損損失	—	4,764
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,344	1,416
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,475	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,853	△ 1,103
製品保証引当金の増減額(△は減少)	1,662	△ 1,655
受取利息及び受取配当金	△ 414	△ 586
売上債権の増減額(△は増加)	1,434	29,918
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 31,377	6,249
仕入債務の増減額(△は減少)	6,785	7,151
未収消費税等の増減額(△は増加)	2,512	7,725
前受金の増減額(△は減少)	4,827	△ 4,978
破産更生債権等の増減額(△は増加)	3,333	—
その他	297	26
小計	44,653	32,564
利息及び配当金の受取額	446	644
利息の支払額	△ 18	△ 20
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 3,894	7,178
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 15,986**	**△ 57,120**
定期預金の増減額(△は増加)	—	△ 48,166
有形固定資産の取得による支出	△ 13,814	△ 8,425
無形固定資産の取得による支出	—	△ 329
その他	△ 2,172	△ 199
財務活動によるキャッシュ・フロー	**317**	**936**
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,502	1,668
配当金の支払額	△ 1,431	△ 715
その他	247	△ 15
現金及び現金同等物に係る換算差額	**△ 1,054**	**373**
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	**24,463**	**△ 15,443**
現金及び現金同等物の期首残高	**123,939**	**65,883**
現金及び現金同等物の四半期末残高	**148,403**	**50,440**

（注） 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. △は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

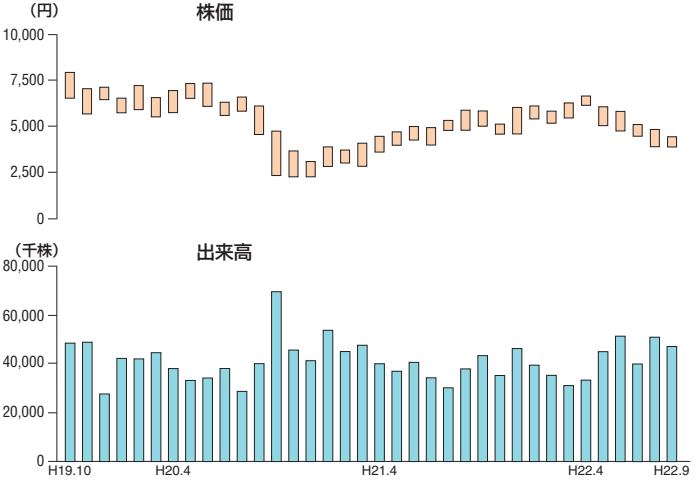
株式の状況（平成22年９月30日現在）

発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式の総数	180,610,911株
株主数	47,660名

所有者別状況



株価と出来高（平成19年10月～平成22年９月）



大株主（平成22年９月30日現在）

株主名	当社への出資状況	
	持株数	出資比率
	千株	%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	19,557	10.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	15,380	8.59
株式会社東京放送ホールディングス	8,727	4.87
ザ チェース マンハッタン バンク 385036	4,650	2.59
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	3,681	2.05
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	3,215	1.79
ＪＰモルガン証券株式会社	3,191	1.78
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	2,884	1.61
ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド	2,666	1.48
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	2,626	1.46

（注）1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 出資比率は、自己株式（1,557,184株）を控除して算出しております。また、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
3. 金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他４社から平成22年４月19日付で提出された変更報告書により平成22年４月12日現在、15,808千株所有している旨、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社及びその共同保有者である他３社から平成22年10月７日付で提出された大量保有報告書により平成22年９月30日現在、9,364千株所有している旨、フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者である他１社から平成22年５月21日付で提出された変更報告書により平成22年５月14日現在、9,283千株所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成22年９月30日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

会社の概況（平成22年９月30日現在）

商　　号	東京エレクトロン株式会社
	TOKYO ELECTRON LIMITED
設　　立	昭和38年11月11日
資 本 金	54,961,191,468円
本　　社	東京都港区赤坂五丁目３番１号
主要な事業所	
府中テクノロジーセンター	東京都府中市住吉町二丁目30番７号
大阪支社	大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番30号
関西テクノロジーセンター	兵庫県尼崎市扶桑町１番８号
山梨事業所	
（藤井地区）	山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の１
（穂坂地区）	山梨県韮崎市穂坂町三ッ沢650番地
仙台事業所	宮城県仙台市泉区大沢三丁目２番地の１
九州営業所	熊本県合志市福原１番地１

取締役・監査役（平成22年11月30日現在）

代表取締役会長	東　哲郎
代表取締役社長	竹中　博司
取締役副会長	常石　哲男
取締役副会長	佐藤　潔
取締役	久保寺正男
取締役	岩津　春生
取締役	北山　博文
取締役	鷲野　憲治
取締役	伊東　晃
取締役	中村　隆
取締役（社外）	井上　弘
取締役（社外）	坂根　正弘
常勤監査役	吉田　光孝
常勤監査役	原　護
常勤監査役（社外）	田近　東吾
監査役（社外）	前田　博

株主メモ

事業年度	４月１日から翌年の３月31日まで
定時株主総会	事業年度終了後３ヶ月以内
基準日	定時株主総会については、毎年３月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当　毎年３月31日 中間配当　毎年９月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関	東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社
（郵便物送付先 電話照会先）	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター ☎ 0120－78－2031（フリーダイヤル）
単元未満株式の買取請求取扱	お取引証券会社等（特別口座で管理されている場合は上記特別口座管理機関）
公告方法	電子公告 （電子公告アドレス http: //www.tel.co.jp/） ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品取引所	東京証券取引所　市場第一部 （証券コード　8035）

VEGETABLE OIL INK

PEOPLE. TECHNOLOGY. COMMITMENT.™